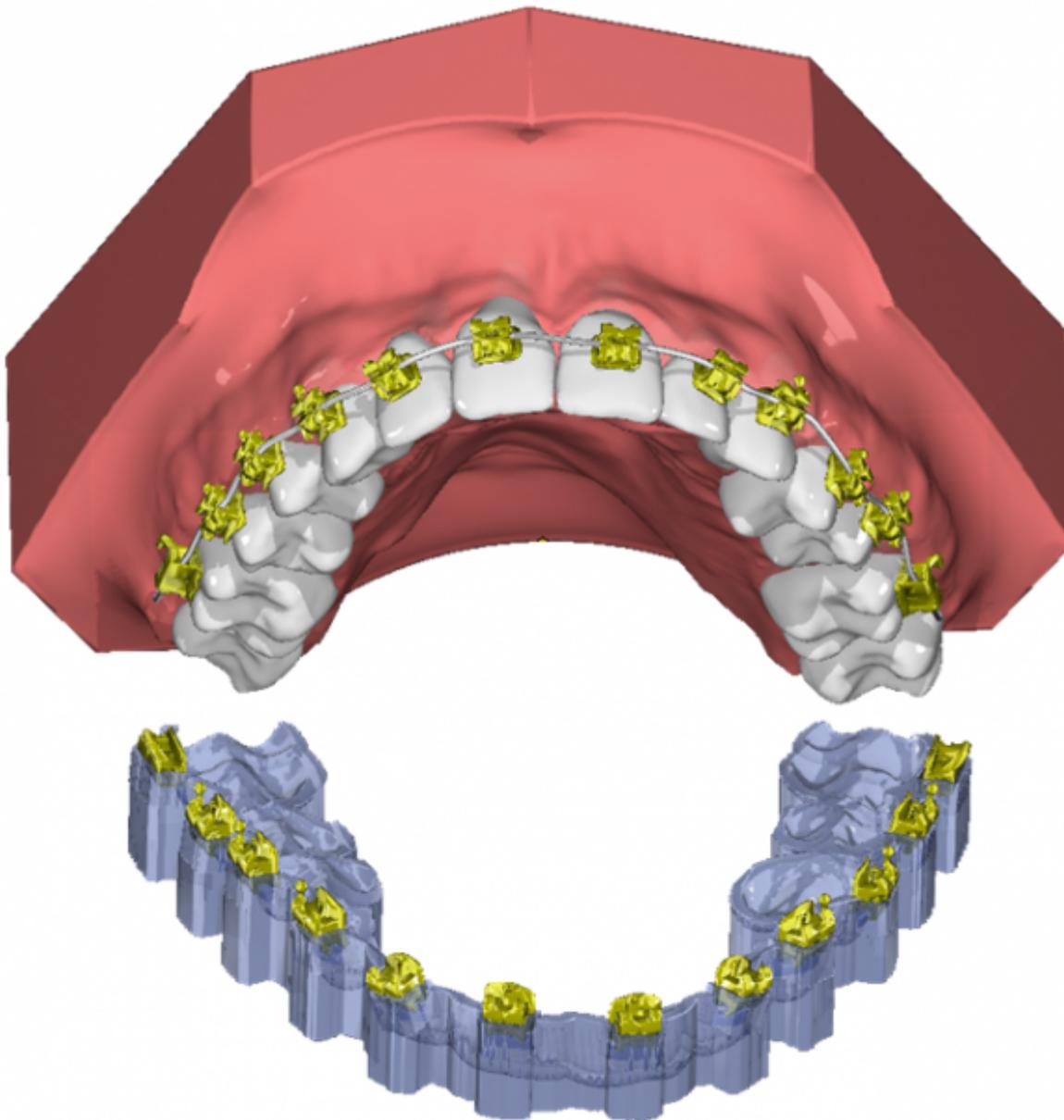


OnyxCeph³™ BondingTrays 3D



Digitale Modelle eröffnen bekanntlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, Arbeitsabläufe im Hinblick auf Zeitaufwand, Kosten und Ergebnis kieferorthopädischer Behandlungen zu optimieren. Neben der virtuellen Planung von Funktions- und Behandlungsschienen, Retainern und Apparaturen betrifft dies vor allem die Techniken des indirekten Kleben.

OnyxCeph³™ bietet mit den Modulen FA_Bonding, V.T.O.3D, Wire_Bonding u.a. spezielle 3D-Optionen, um die unterschiedlichsten Varianten und Konzepte der Berechnung von Bracket-positionen sowie Ziel- und Finishingdrähten umzusetzen. Auch für die Übertragung der virtuell ge-planten Bracketpositionen auf den Patienten werden mehrere Techniken unterstützt.

Vor dem Hintergrund der schnell voranschreitenden Entwicklung im Bereich von aufbauenden Herstellungsverfahren (z.B. 3D-Druck) und entsprechend geeigneter Materialien steht derzeit auf Anwenderseite besonders Modul BondingTrays im Fokus des Interesses. Das Modul stellt eine Vielzahl von Parametern bereit,

um Bracket-Übertragungsschienen direkt am virtuell beklebten Modell zu konstruieren und diese als 3D-Datensatz lokal oder an die in OnyxCeph^{3™} hinterlegten Dienstleister zu exportieren oder auch direkt an 3D-Drucker zu senden.

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link:

<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=bdk4>

Last update: **2018/03/15 17:44**

